

2020年3月期第2四半期決算電話会議議事録

参考資料:2020年3月期第2四半期決算説明資料

(補足) PKG: パッケージ基板

HDI : マザーボード(High Density Interconnect)

サブトラクティブ工法 (サブトラ): 一般銅箔を使用して回路を形成する工法

MSAP工法 : 当社の極薄銅箔MicroThin™を使用して回路を形成する工法

【全体】

- Q. 在庫要因を除くと、上期から下期にかけて業績が減益基調となっている。その中で、機能材と金属の減益基調について解説をお願いします
- A. 機能材料については、銅箔特にMicroThin™のうち、HDI向け販売量の大幅減が大きな要因。更に触媒の値下げ織り込み、研究開発費の増加等で上期から下期でマイナスとなっている。金属については、水力発電の利益が上期に偏っており、下期が10億円程度マイナス。また銅関連はPPC製錬で下期に定修費用を織り込んでいる

【機能材料セグメント】

- Q. 在庫要因除きの機能材料の経常利益について、19Q1→19Q2にかけて7億円程度よくなっているが、銅箔、機能粉など主要製品のQ on Qでの利益の変化について教えて下さい。
- A. 19Q1から19Q2にかけて改善しているのが銅箔。MicroThin™、一般箔共に需要が立ち上がってきている。機能粉は需要がまだ回復していないので動きがなく横ばい
- Q. MicroThin™、一般銅箔を含めてマーケットの環境を教えてください。前回と比べて何か進展はあったのでしょうか。また銅箔の実績と見込のうち、PKG向けとHDI向けの割合を教えてください
- A. 一般銅箔は通信インフラ向けの需要が旺盛であり、上期から下期にかけて伸びてきている。MicroThin™のPKG向けについて、新たな採用の拡大は聞いていない。HDI向けについては、下期に韓国系、中華系の採用増を見込んでいたが、現時点では採用を見ておらず、下期のHDI向け減販の一因になっている。5G関連では、一般銅箔の通信インフラ向けが需要旺盛で、5G向けの需要が本格的に開始したと認識。MicroThin™のうち、HDI向け比率は、上期実績:25%弱、下期:15%弱、通期見込:20%弱
- Q. HDI向けMicroThin™で韓国系、中華系が入ってこない見込みですが、どういうことなのか。韓国系に関しては、代替品は何になるのか。また中華系の採用見送りの背景について、詳細をご解説下さい
- A. 韓国向けは、韓国系企業の購買方針の変更により、今年度下期から採用を予定していた来年度モデル2機種のうち1機種でMTの採用をやめた。購買方針の変更には日韓の貿易問題が背景にあると見ている。韓国系は、代替としてサブトラを採用すると聞いている。MicroThin™を使用するより歩留は悪くすると見ているが、日系企業から材料を買うリスクを考慮したのではないかと。中華系についても、今年度の下期は採用がなくなった。確たる理由は把握していない。
- Q. 上期から下期にかけて、MicroThin™の販売数量指数が大きく下がる前提だが、北米メーカーのHDI向けが減るという理解でよいでしょうか。また計画に対して足元の状況はどうか。
- A. その通り。今回も通常通り上期ピークを迎え、下期以降は落ちてしまうという見込み。期初計画との対比では大きく減販しており、MicroThin™の採用層数減少が大きな要因。
- Q. HDI向けMicroThin™のうち、韓国系、中華系がなくなったことによるインパクトはどのくらいか
- A. ウェイト自体は大きくはない。HDI向けのうち10-20%ぐらいのインパクト

- Q. データセンター向け等、非スマホ向けMicroThin™の動向について教えてください
- A. 新規用途が出てきたわけではないが、計画通り伸びている。用途としては、主にサーバーのメモリやGPU向け
- Q. MicroThin™の販売量指数が19Q2の132から下期100に下がる要因は、北米向けのピークアウトを前提としている部分が多いのでしょうか
- A. その通り。加えて19Q2にPKG向けで韓国企業から実需以上に在庫分の注文が入ったこともある
- Q. PKG向けMicroThin™について、19Q2で前倒し注文があった割に、下期のPKG向けの数量が減らない理由を教えてください
- A. 19Q2は在庫需要を含んでいるが、日韓の貿易問題の長期化リスクもあり、下期でその在庫が調整されないと見ているため
- Q. 一般箔のフレキ向けについて、韓国向けの前倒しはなかったのでしょうか。また、通信インフラ向けとフレキ向けの数量は、上期実績もしくは通期見込でどのくらい伸びているのか教えてください
- A. フレキ向けについて、前倒し需要があったという話は聞いていない。上期の対前年同期比では、通信インフラ向けは+5%、フレキ向けは-5%
- Q. MSAP層数について、実際どのくらい減ったのでしょうか。また、採用層数が減った理由はどうお考えでしょうか
- A. メイン基板の10層中6層使われていたのが、今年度は4層になったのが大きな要因。採用層数が減った理由は、コストを重視する方向が今まで以上に強くなったのではないかと
- Q. 韓国企業との取引について、当面は日韓問題リスクを見ておいた方がよいのか。また回復するのであれば、来年MicroThin™の売上が伸びるシナリオはどうか教えてください
- A. MicroThin™については色々な見方がある。HDI向けは基板設計次第。日韓貿易問題については、次期機種を見据えた設計上、高機能化を求めれば戻ってくる可能性はある。PKG向けは今後も5G向けが期待され、着々と伸びてくると見ている
- Q. 5G用途で足元通信インフラ向け銅箔が増加しているが、来期以降に向けて通信インフラ向けの一般箔が増益要因となりえるのか教えてください
- A. 通信インフラ向け一般箔はハイエンドおよびミドルレンジ双方とも引き合いはかなり来ており、2020年以降期待できる。
- Q. 機能粉の状況について、下期は回復しそうですでしょうか。19Q2から下期にかけて、数量の動向について教えてください
- A. 電材向け銅粉は、下期から回復してくると見ているが、水準としてはまだ低い。ただし18Q3、Q4から続いていた在庫調整は底を打ったと感じている
- 【その他】
- Q. 親会社株主に帰属する当期純利益の下方修正幅が、経常利益の下方修正幅が同じとなっているが、内容を教えてください
- A. 今回減益となるのは主に連結納税会社であり、元々税金費用を少額しか見込んでいない会社のため、減益による減税インパクトがないという状況